



無償購読申込・変更

Email Newsletter登録

広告資料請求

EDN.com | EDN Asia | EDN China | EDN Australia

EDNJapan記事検索

検索方法の詳細はこちら



Latest News

2004年11月15日

**UWBシステム開発用デザイン・キットを
イスラエルのウィザー社が発売**

イスラエルの通信用半導体メーカーであるウィザー社は同社のUWB (Ultra Wide Band) LSIチップセットを使ったUWB応用機器の開発に向けたデザイン・キット「DV9100 DVK Module」を開発し、2005年1月より出荷を始める(図1)。価格は150万円。

同社はすでにUWB用のLSIチップとして2004年4月にMBOA(Multi Band-OFDM Alliance)規格向けの高周波トランシーバーIC「RF501」を開発し、2004年10月には同規格向けの物理層(PHY)ベースバンドIC「BB530」を開発した。このうちRF501はMBOA規格に準拠した最大480Mビット/秒のデータ転送速度に対応しており、BB530は最大200Mビット/秒に対応している。いずれも試験用のチップという。

新規に開発したデザイン・キットは、RF501およびBB530を搭載している。またMAC(Media Access Control)部はFPGAを使用している。大きさは6インチ×2.4インチ(約15cm×6cm)のプリント基板に組み込まれている。外部機器とのインターフェースを含めたデータ転送速度は100Mビット/秒で到達距離は10m以上となっている。周波数帯域は3.1G~6.1GHzで6.528GHzのMBOAサブ・バンドをサポートする。周辺機器とのインターフェースは、MBOAのMAC物理層インターフェース、100Base-Tイーサネット・インターフェース、トランスポート・ストリームSPIインターフェース、USB1.1ホスト・インターフェースなどを搭載している。

また、同社はUWBチップセットの展開を以下のように計画している。2005年3月に現行チップの低消費電力化を測った「RF502」と、外部インターフェース回路を内蔵した「BB531」をリリースする。この品種が実際の製品となり、200Mビット/秒のデータ転送速度に対応する。2005年の第3四半期にRF502と、MAC機能を内蔵した「BB540」で480Mビット/秒に対応する。インターフェースもUSB2.0に対応する。2006年第1四半期には高周波部、ベースバンド部、MAC部をすべて集積した「RF BB601」でワンチップ化した製品をリリースする予定という。(渡辺 二之)



図1 UWB応用機器デザイン・キット
インターフェースは100Base-TのイーサネットとUSB1.1を備える。外部機器への入出力を含めた伝送速度は100Mビット / 秒。

- ▶ 連絡先： ウィザー社日本事務所、電話03-5462-9644
- ▶ 詳細： [ウィザー社（ホーム・ページ）](#)

Advertisement

>>>他のニュース

[HOME](#) | [EDN Japan について](#) | [無償購読申込・変更](#) | [サイトマップ](#) | [お問い合わせ](#) | [広告掲載について](#)

[個人情報に関する方針](#) / [会社情報](#)